

HRG3000RMX

High Rigid Grinder

全自動高剛性 3 軸研削盤

短時間でダメージがない加工を実現

低加工コスト

高精度加工

鏡面加工を実現します



対象材料

Si

対象ワーク

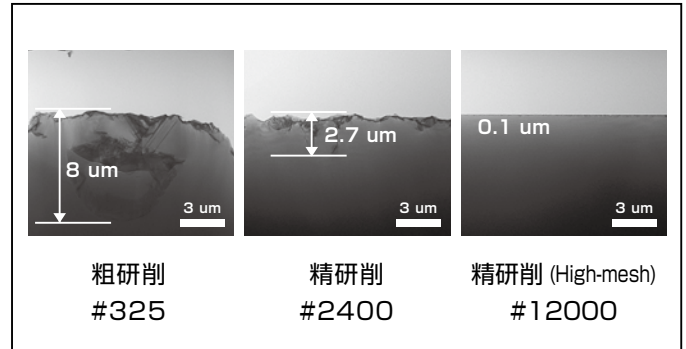
サイズ：φ8～φ12インチ

スループット

研削ダメージ

Planning condition (UPH35)		
Rough (#325, 10 μm/sec)	Process time 82 sec (658 μm)	Setup 20 sec
Semi-fine (#2400, 3 μm/sec)	82 sec (80 μm)	Setup 20 sec
Fine (#10000, 0.25 μm/sec)	82 sec (10 μm)	Setup 20 sec
Handling	85 sec	

UPH 3600/102=35.3



仕様



項番	項目	HRG3000X
		全自動高剛性3軸研削盤
1	外観	サイズ:1750(W)X3525(D)X1978(H)mm 重さ:11000 kg
2	最大加工径 (mm)	300
3	砥石径 (mm)	300
4	砥石軸回転数 (rpm)	3600
5	ワーク軸回転数 (rpm)	650
6	砥石軸モータ (kw)	11
7	ウェハ面内厚みばらつき: TTV(μm)	0.5 (Auto TTV 使用時)
8	ウェハ間厚みばらつき: WTW(μm)	± 0.5 (Auto TTV 使用時)



項番	項目	RM3000-HRG
		サイズ:1500(W)X4250(D)X1800(H)mm 重さ:1600 kg
1	外観	
2	最大加工径 (mm)	300
3	最大ダイシングテープ径 (mm)	外径φ 230 (最大幅 430 mm)
4	最大剥離テープ径 (mm)	外径φ 200 (最大幅 50 mm)
5	ウェハマウント精度	チャックテーブル中心に対して 0.5 mm 以内 フレームのノッチ方向に対して 0.5 度以内

株式会社東京精密

お問合せはお近くの取扱店まで

<https://www.accretech.jp>

■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所 Tel. (042) 631-5211 Fax. (042) 631-5234
 大阪営業所 Tel. (06) 6821-0361 Fax. (06) 6821-0210
 九州営業所 Tel. (096) 241-2101 Fax. (096) 386-1592

■ 半導体製造機器サービスステーション

北上出張所 Tel. (022) 224-0177 Fax. (022) 224-7083
 仙台出張所 Tel. (022) 224-0177 Fax. (022) 224-7083
 山形出張所 Tel. (023) 631-5125 Fax. (023) 625-4129
 鶴岡出張所 Tel. (0235) 29-8020 Fax. (0235) 29-8022
 東京CE課/土浦出張所 Tel. (029) 834-8550 Fax. (029) 831-6808
 東京CE課 Tel. (042) 642-0358 Fax. (042) 642-0367
 北陸出張所 Tel. (076) 422-6756 Fax. (076) 422-6757

四日市出張所 Tel. (059) 361-6610 Fax. (059) 366-2210
 大阪CE課 Tel. (06) 6821-0225 Fax. (06) 6821-0210
 東広島出張所 Tel. (082) 493-5618 Fax. (082) 493-5619
 九州CE課 Tel. (096) 387-5188 Fax. (096) 386-1592
 九州CE課/大分出張所 Tel. (097) 503-1035 Fax. (097) 503-1036
 長崎出張所 Tel. (096) 387-5188 Fax. (096) 386-1592
 国分出張所 Tel. (0995) 43-2510 Fax. (0995) 43-2586
 八王子パーツセンター Tel. (042) 642-0381 Fax. (042) 642-0397

■ 東精エンジニアリング

土浦半導体工場 Tel. (029) 830-1882 Fax. (029) 832-5742
 土浦半導体工場/パーツセンター Tel. (029) 830-1882 Fax. (029) 832-5742